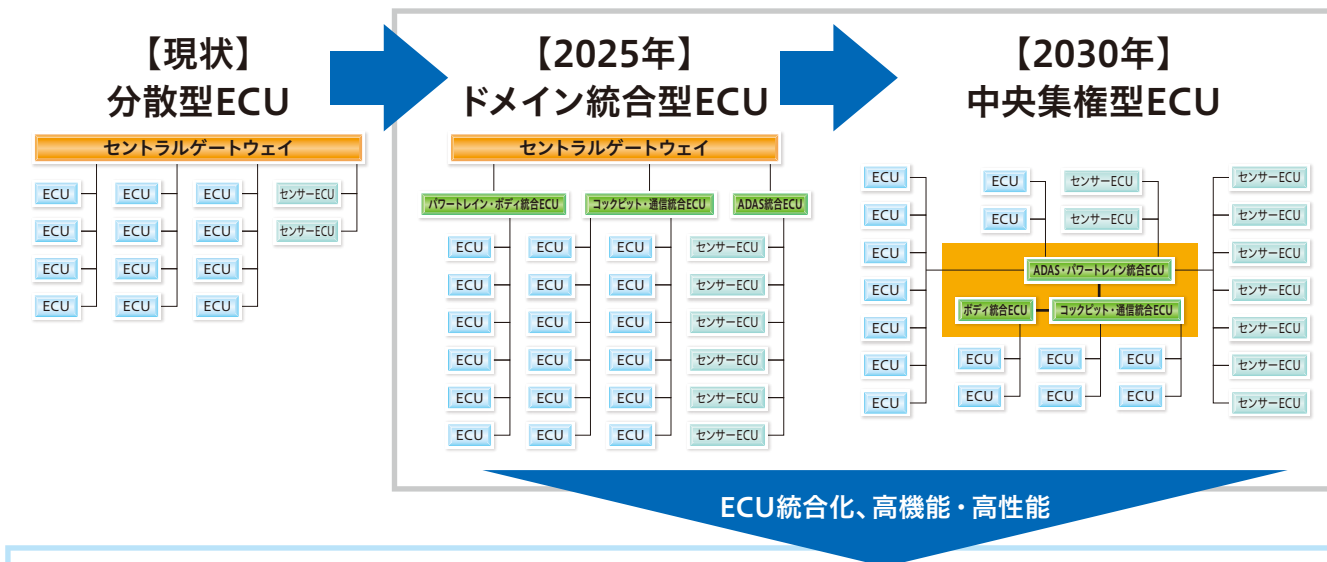


車載用途プリント配線板 技術ラインナップ

Automotive PWB Technology Lineup

プリント配線板に求められる技術



高密度・高周波

部品高機能・高性能化⇒狭ピッチ配線
高速信号通信⇒高周波対応

小型化

省スペース化
3D実装対応

放熱

部品発熱⇒プリント配線板での放熱対応

技術ロードマップ

製品課題	開発アクション	25年度	26年度	27年度
SI品質向上のための 高速伝送対応	要求特性に応じた低誘電材の提案	低誘電材の多層化技術確立		
	インピーダンス管理 パターン形成性精度	パターン形成法 および 測定方法 の評価		
	無粗化処理	薬液による無粗化処理の技術開発		
	ノイズ対策	シートコデンサー内蔵	構造およびプロセス検討・構築	
システム統合に伴う Soc搭載数の増加 ・発熱 ・そり	高耐熱部材の選定	高TgSRの提案	更なる耐クラック性SRの開発	
		高Tg基材の提案	高Tg基材の開発	
	実装信頼性向上	低CTE材の提案	低CTE材による技術開発	
高多層対応	車載信頼性に対応する高多層化技術の確立	技術確立		
L/S=50/50対応	車載対応ファインパターン形成技術	技術確立		
環境対応	カーボン処理工法の技術確立	信頼性評価		
	三次元基板形成工法	三次元技術の確立		